

ポスト5G通信を支える基盤技術

2022年2月25日(金) 13:30~16:20

Zoom Webinar
ON-LINE開催

共催:

大阪大学F3D実装協働研究所
経済産業省 近畿経済産業局

後援:

一財)大阪大学産業科学研究協会 一社)日本電気計測器工業会(JEMIMA)
一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP) 一社)電子情報技術産業協会(JEITA)

13:40~14:30 ポスト5G/6Gに向けた低誘電材料と有機無機接着接合

株式会社ダイセル スマートSBU 八甫谷 明彦 氏

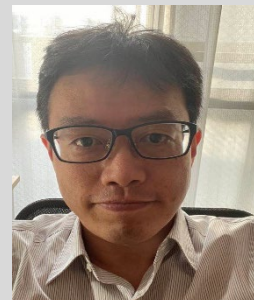
【概要】ポスト5G/6Gではミリ波、テラヘルツ帯の利用が見込まれており、伝送損失を低減するために絶縁材料の比誘電率と誘電正接はより小さく、導体と絶縁材料の界面は平滑であることが求められる。ここではプリント配線板の低誘電材料、及び接着・接合技術について解説する。



14:40~15:30 次世代情報通信における材料面での長瀬産業株の取り組みについて

長瀬産業株式会社
情報通信・エネルギー事業室 情報通信材料部 宮木 伸行 氏

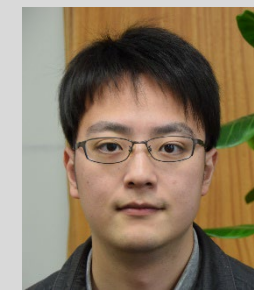
【概要】5Gを中心とする次世代情報通信の分野において、特に高速/大容量データ通信端末、基地局やミリ波レーダーに必要な低誘電材料等についての弊社での開発を含む取り組みについて述べたいと思います。



15:30~16:20 セルロースナノファイバーを用いた水濡れ故障対策技術とその応用

大阪大学産業科学研究所 自然材料機能化研究分野 春日 貴章 先生

【概要】センサデバイスをはじめとする情報収集機器の生産数・設置数は増え続けている一方で、持続可能性への配慮も求められています。本講演では、セルロースナノファイバーによる水濡れ故障抑制技術及び、故障抑制メカニズムを応用した成形加工技術をご紹介します。



※公開講座内容について、都合により一部変更になる可能性があります。ご了承ください。

お問合せ

大阪大学フレキシブル3D実装協働研究所
http://www.f3d.sanken.osaka-u.ac.jp/
MAIL f3d@sanken.osaka-u.ac.jp
TEL 06-6879-4295 (平日 9:00-17:00)

お申込み

1)WEBからのお申込み:
<https://forms.gle/BqMFxEtUytzqf1y9>
2)メールからのお申込み:
f3d@sanken.osaka-u.ac.jp



※メールでお申込みの際は、お名前・ご所属・住所及びZoom接続可能メールアドレスをご記入下さい。